1：技术参数规格说明		
NO.	项目	描述
1	厂家	Mattson
2	等离子体方式	ICP 感应耦合电浆(13.56MHZ 1000w)
3	Wafer size	6″/8″（不可兼容，可升级）
4	处理方式	双腔，每腔2个Head 可同时处理4片Wafer 每个头对应一个Generator & Match
5	装置构成	Process chamber x 2 Loadlock chamber x 1 Shuttle chamber x 1 Cass chamber x 1 4片式机械手臂 x 1
6	Carrier Port	2个硅片载具入口 可同时放入2盒花篮
7	机台尺寸（WxDxH）	1750 x 2050 x 2250
8	维护尺寸（WxDxH）	3700 x 3710 x 2670

2：稼动能力		
NO.	项目	描述
1	生产速度 （Recipe Time 60s）	>150 片每小时 （双腔，Continue模式）
2	稼动可能率（Uptime）	>95%
3	故障率	<2%
4	微粒数量 >0.2um	<20EA
5	PM 周期	1000h
6	PM 所需时长	4-8h

3：设备性能		
NO.	项目	描述
1	Online/Barcode对应	对应
2	Recipe Network对应	对应
3	Carrier Port	有
4	Vacuum Leak Check测定功能	有
5	最大Recipe/Step数量	99 Recipes / 10 Setps
6	Stage温度控制功能（加熱機構）	有

4：工艺参数		
使用气体		O2,PN2,CF4,4%H2N2
250℃	去胶速率 ER	60000±10000 A/min
	去胶均匀性 Uni%（片内）	≤5%
	去胶均匀性 Uni%（片外）	
100℃	去胶速率 ER	950±100 A/min
	去胶均匀性 Uni%（片内）	≤7%
	去胶均匀性 Uni%（片外）	